



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2024年11月

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



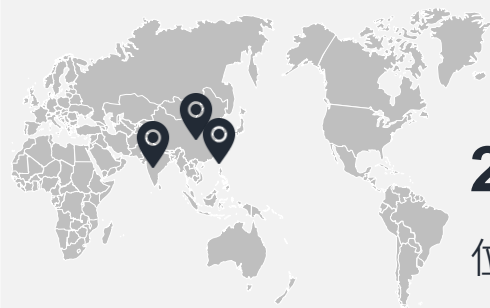
## 全球第1大

### 印刷電路板製造公司

**2006年** 成立  
(前身華虹電子 1978)

**台灣桃園** 總部

**46,693**  
2023年底員工數



**26** 座工廠

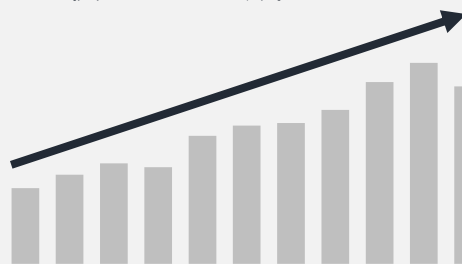
位於大陸、台灣、印度

**NT\$1,514億**

2023年營收(-11.6% YoY)

**+9%**

2013-2023年  
營收年複合成長率



**1,796**

累計有效獲證專利件數

**3,739**

累計專利申請  
(截至2024年8月底)



**NT\$1,124億**

2024年11月11日市值

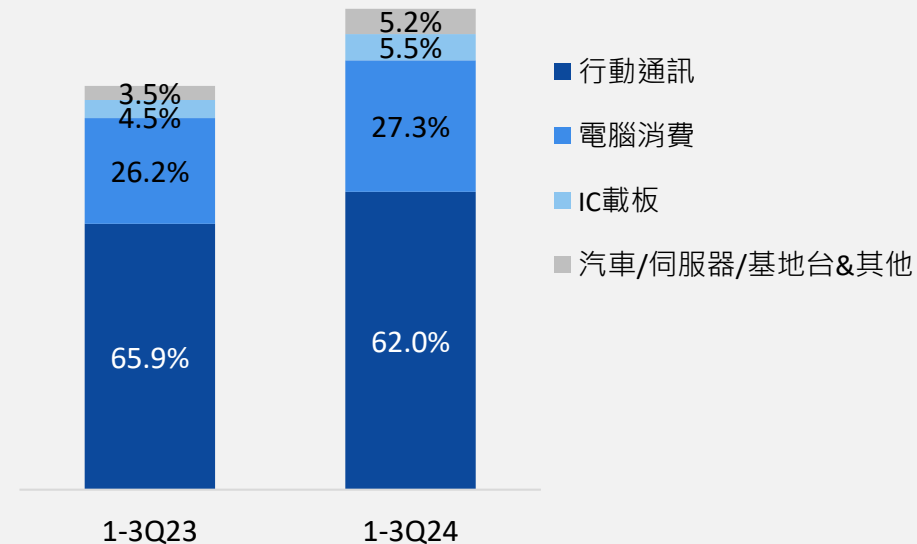
**14.7%**

10年平均股東權益報酬率

### 銷售分析 - 產品應用別

**+19.1% YoY**

NT\$970億 → NT\$1,155億



## 為何投資臻鼎？

1

### 全球第一大PCB廠，長期穩健成長：

臻鼎自2017年起，榮登全球第一大PCB廠，2013-2023年營收年複合成長率達9%。

2

### 發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距：

以One ZDT為核心策略，發揮一站購足綜效，持續追求穩健成長。臻鼎2023年全球PCB市佔率為7.0%，目標2030年提升至10%。

3

### 積極拓展IC載板業務：

臻鼎規劃於2022-2027年投資新台幣600億元資本支出於IC載板，目標2030年成為全球前五大IC載板供應商。

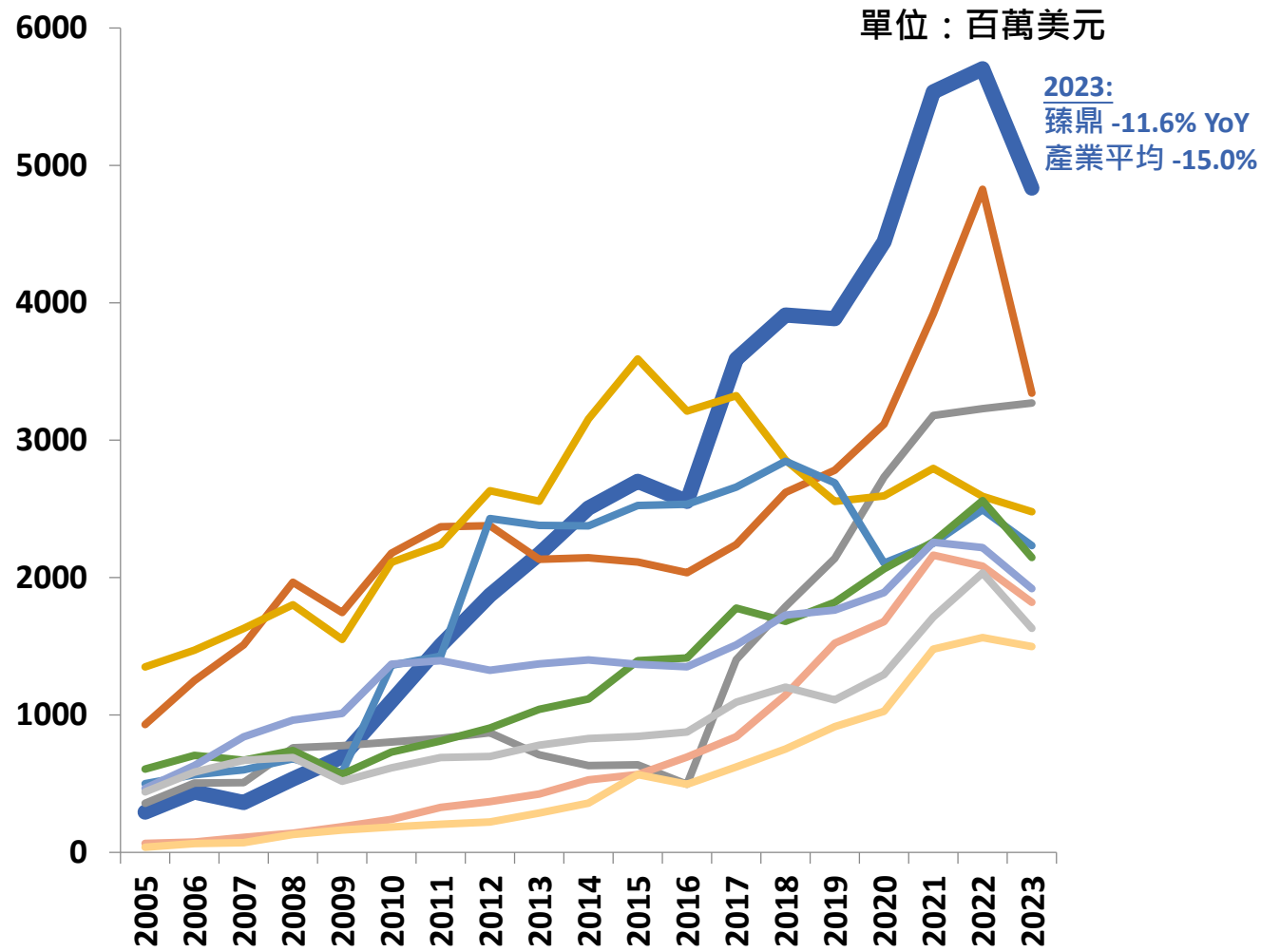
4

### 全球化生產基地：

除大陸三座主要生產基地，臻鼎在台灣、印度亦設有廠區，目前正於泰國建置新廠，同時規劃將高雄廠打造為AI園區，未來將持續拓展全球化生產基地，服務多元客戶需求。

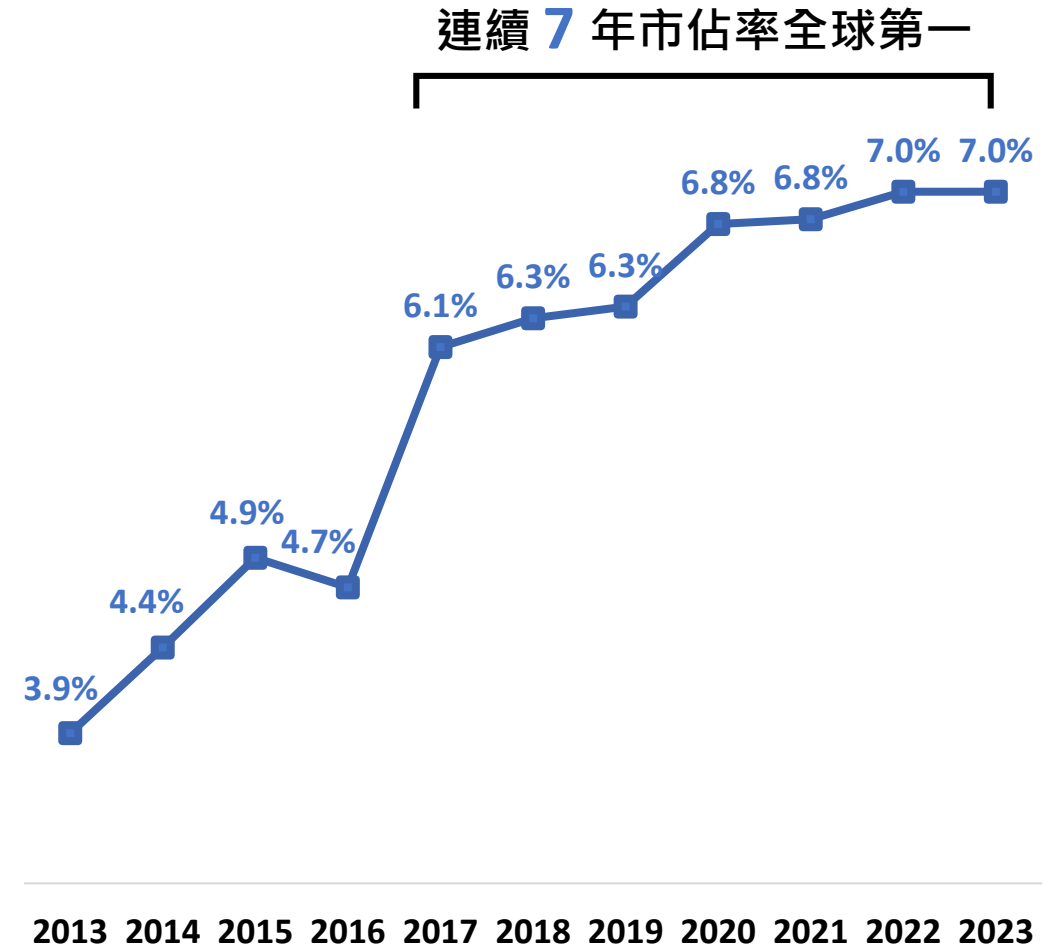
全球第一大PCB廠，長期穩健成長

## 2023全球前十大PCB領導廠商營收趨勢



資料來源：NT Information；Prismark (2024/02)

## 臻鼎持續保持PCB產業領先市佔率



資料來源：Prismark

1

**第三季營收刷新歷年同期新高紀錄，四大應用同步季增與年增：**

第三季營收成長強勁並達到歷年同期新高，季增56%，年增21%，其中行動通訊受惠客戶新品出貨旺季效應，創下歷年同期新高，同時IC載板及車載/伺服器/基地台雙雙創下單季新高。

2

**第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標，並正向看待明年客戶新品PCB價值提升的機會：**

由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，產能利用率將維持高檔。此外，隨著AI手機硬體效能要求越來越高，將推動產品結構設計與材料方面的變化，臻鼎正向看待明年客戶新品PCB價值提升的機會。

3

**AI伺服器方面積極參與客戶次世代架構新品，光通訊產品亦已順利進入量產：**

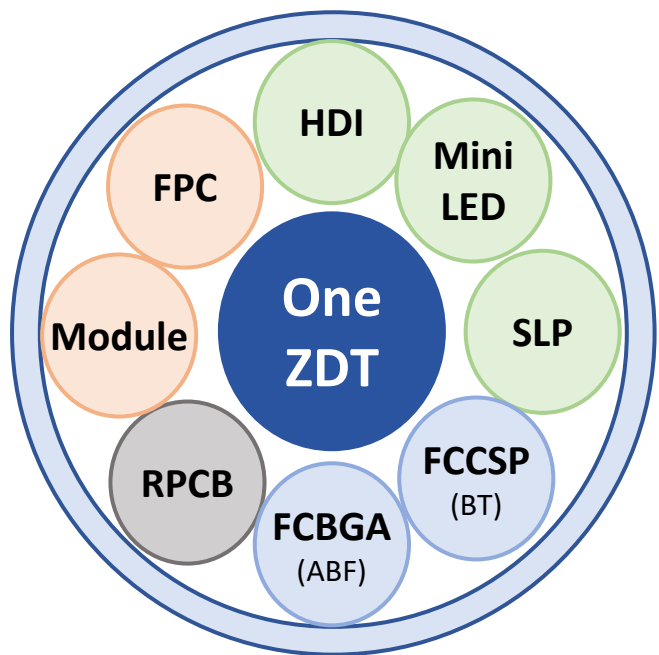
臻鼎於伺服器領域耕耘多年，不僅參與客戶新一代AI伺服器產品打樣，同時亦積極參與客戶次世代架構新品。另外，光通訊產品方面已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證。

4

**泰國新廠第一期維持1H25試產、2H25小量產；高雄廠將打造為AI園區：**

泰國新廠第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，待新廠進入量產，將可滿足相關產品的客戶需求。同時臻鼎規劃將高雄廠打造為AI園區，提供高階AI產品設計與製造產能，支應日漸增加的全球AI產品需求。

從AI終端裝置至AI伺服器 – AI應用朝多元化發展，將使PCB板設計趨於複雜  
臻鼎提供業界最完整與先進的PCB產品，打入AI相關的全方位應用

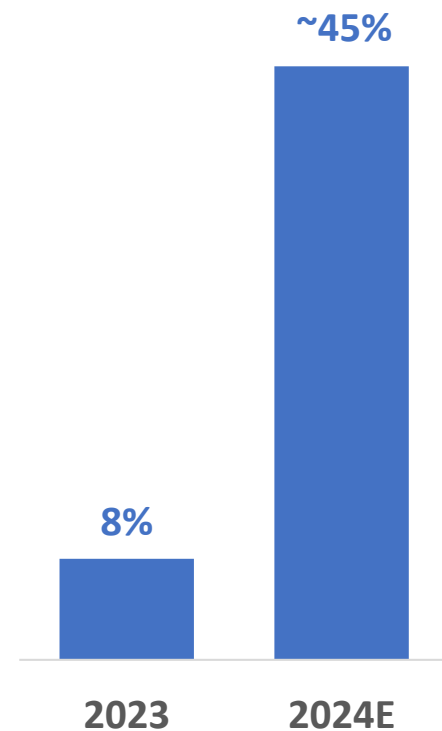


AI



AI 伺服器	邊緣運算 伺服器	高速運算 記憶體	
光通訊	交換器	基地台	
AI 手機/ 晶片	AI PC	AI 平板	智能穿戴
AR/VR 元宇宙	智能車用 智慧座艙 域控制器	自動駕駛 車用晶片	新能源車 電池板

■ 臻鼎AI營收占比

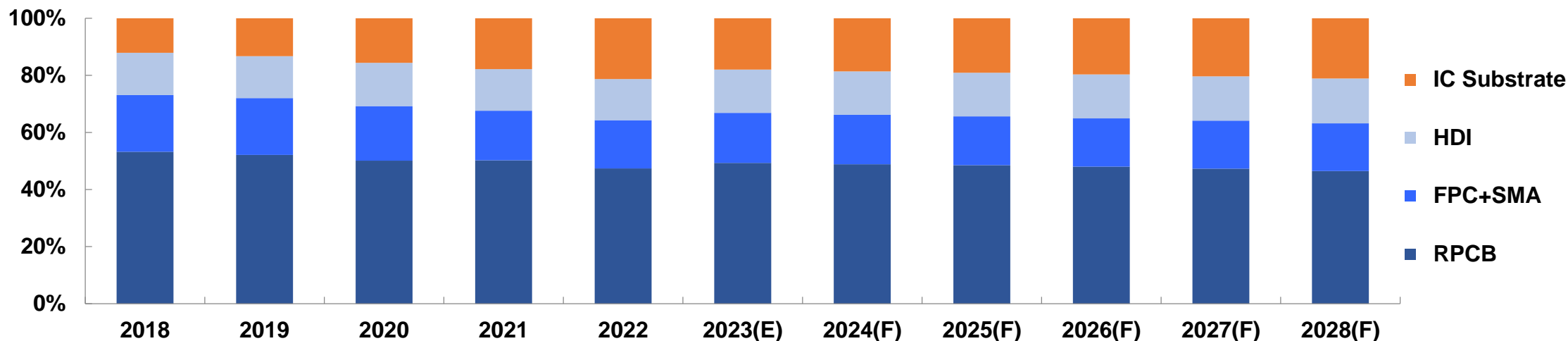




發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距

目標2030年全球PCB市佔率達10%

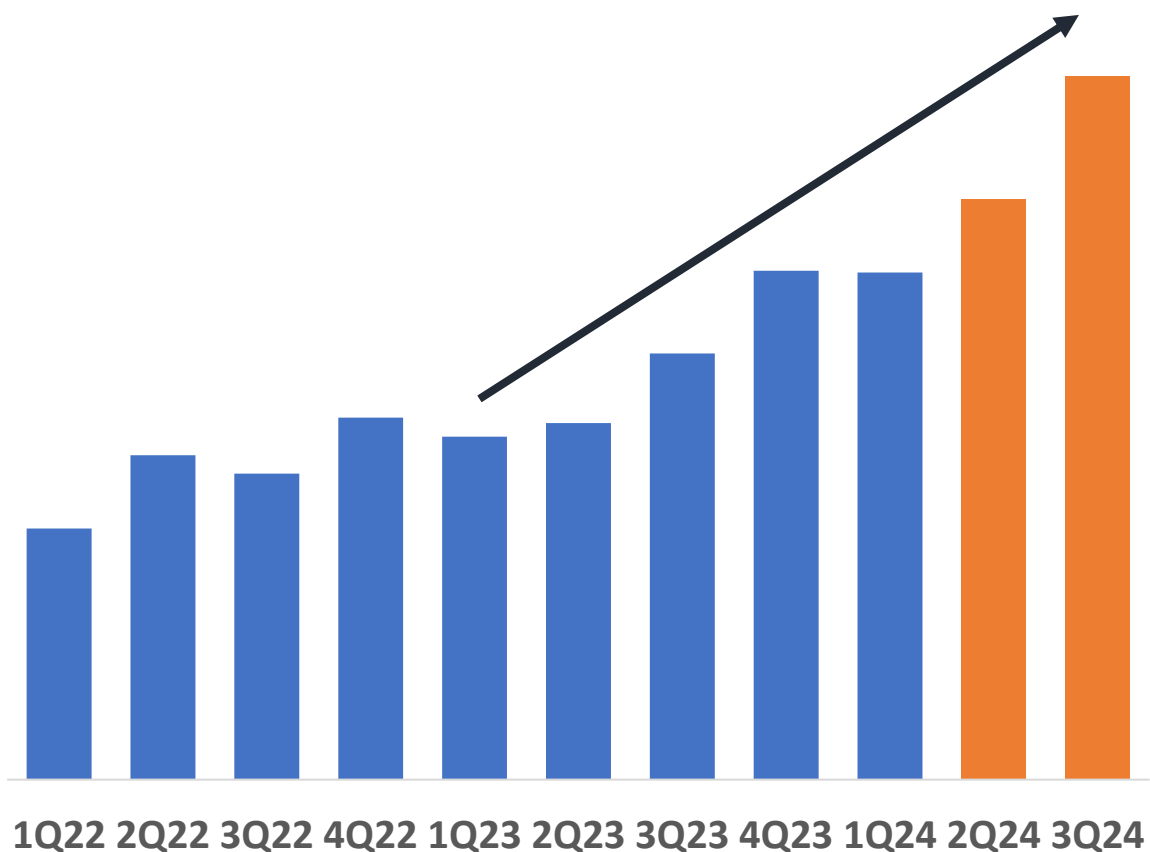
# 各類PCB市場規模將於2024年重回成長軌道



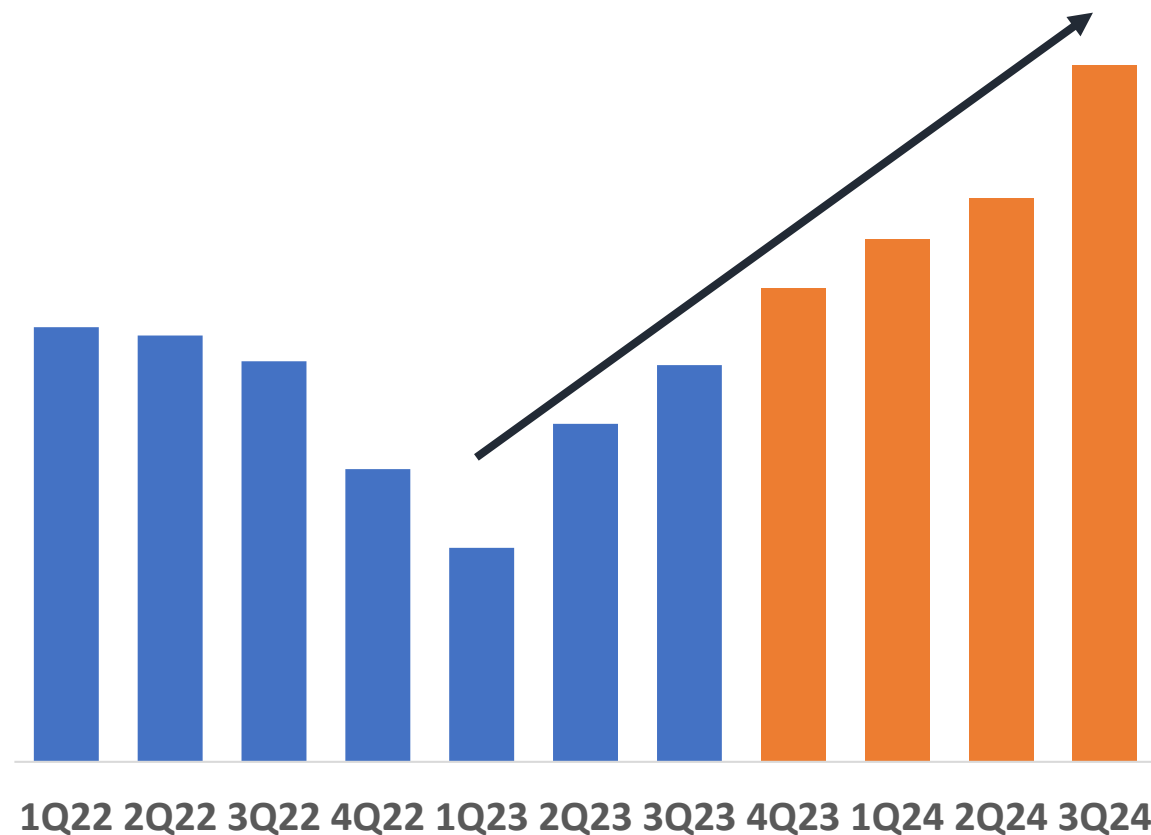
產品	項目	2018	2019	2020	2021	2022	2023(E)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2023-2028 CAGR
RPCB	產值	33,225	31,969	32,674	40,641	38,720	34,292	35,387	37,472	39,174	40,553	41,405	3.8%
	佔全球比	53.2%	52.1%	50.1%	50.2%	47.4%	49.3%	48.2%	48.1%	47.6%	46.9%	45.8%	
FPC+SMA	產值	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	12,191	13,106	13,693	14,307	14,947	15,617	5.1%
	佔全球比	19.9%	19.9%	19.1%	17.4%	16.9%	17.5%	17.9%	17.6%	17.4%	17.3%	17.3%	
HDI	產值	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	10,536	12,024	12,776	13,575	14,424	15,326	7.8%
	佔全球比	14.8%	14.7%	15.1%	14.6%	14.4%	15.2%	16.4%	16.4%	16.5%	16.7%	17.0%	
IC Substrate	產值	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	12,498	12,829	13,975	15,224	16,584	18,065	7.6%
	佔全球比	12.1%	13.3%	15.6%	17.8%	21.3%	18.0%	17.5%	17.9%	18.5%	19.2%	20.0%	
合計		62,396	61,311	65,219	80,920	81,740	69,517	73,346	77,916	82,279	86,508	90,413	5.4%
年增率		6.0%	-1.7%	6.4%	24.1%	1.0%	-15.0%	5.5%	6.2%	5.6%	5.1%	4.5%	

資料來源：Prismark (2024/9)；2025~28年係用Prismark數據推估。

臻鼎車載/伺服器/基地台營收續創單季新高

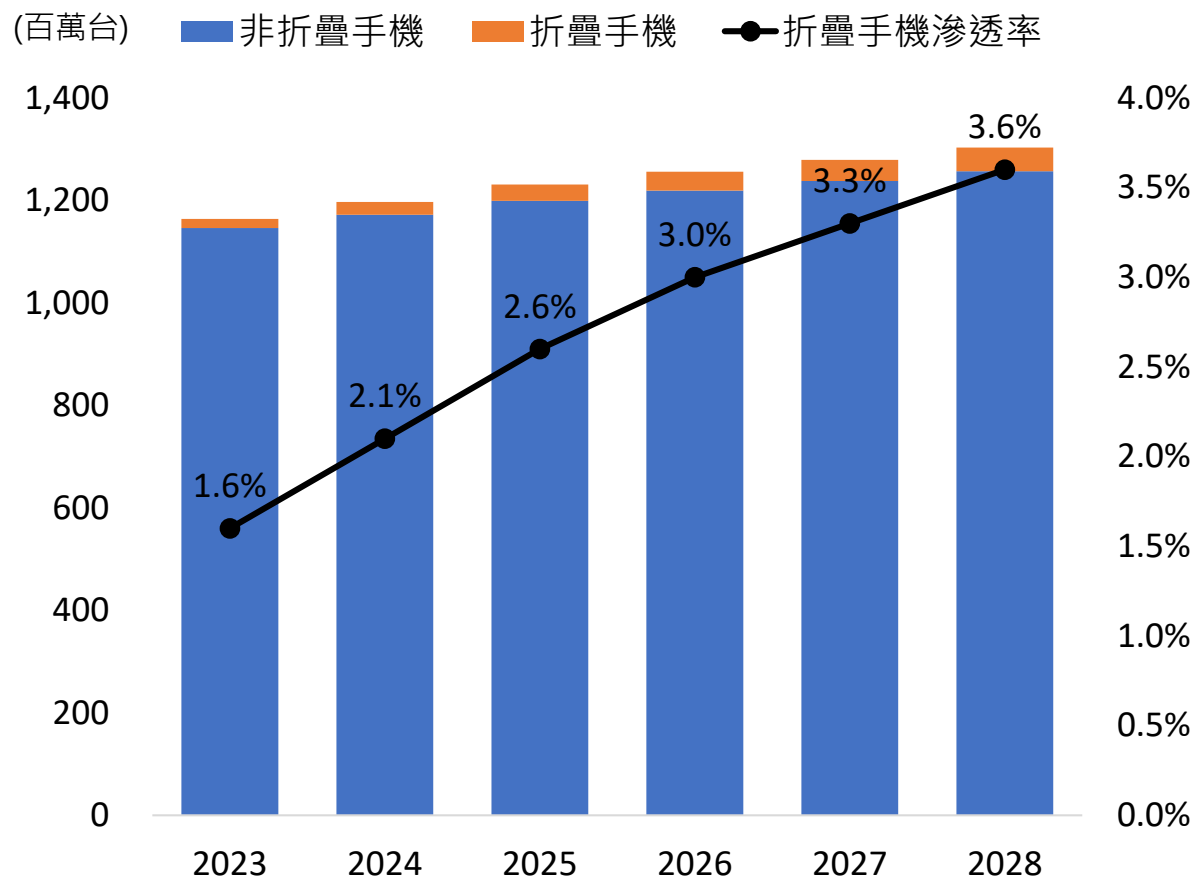


臻鼎IC載板營收連續四個季度創下單季新高



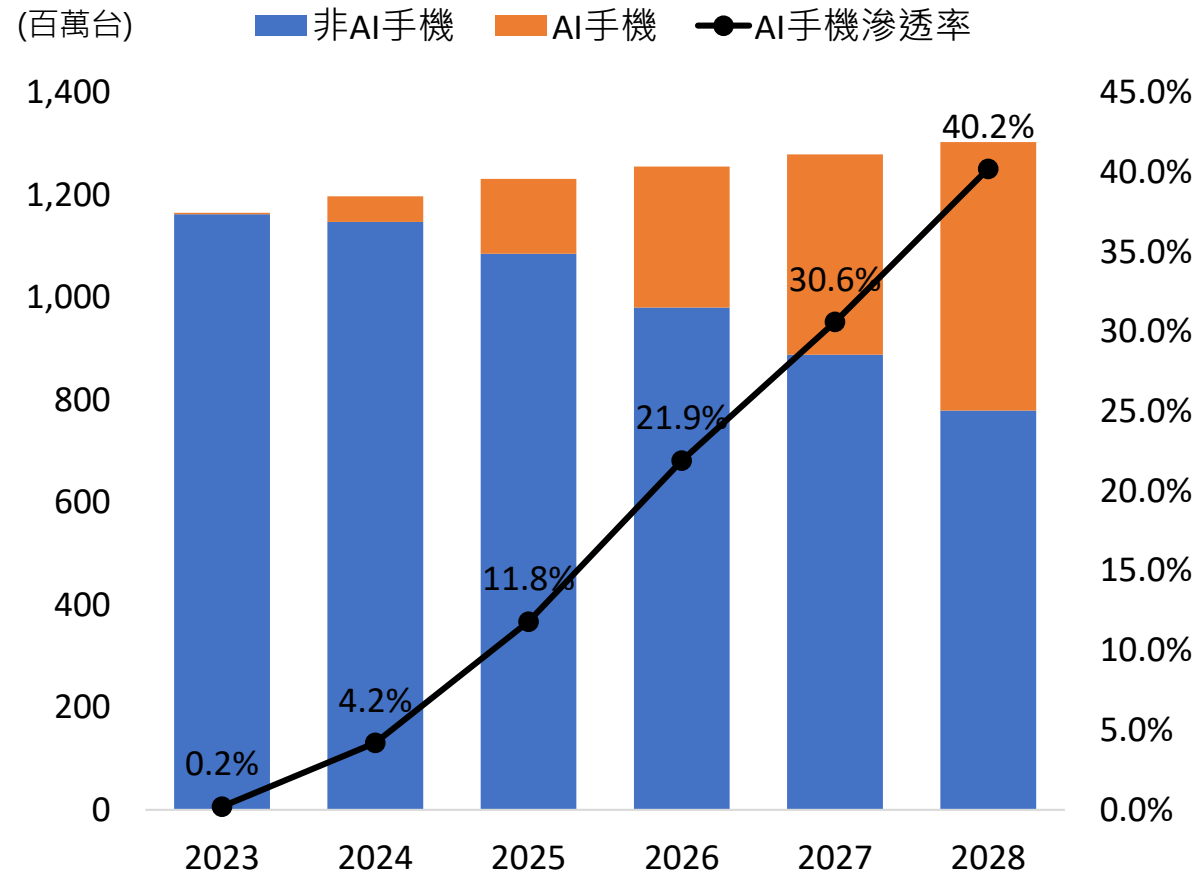
- 1 臻鼎加速開發與AI伺服器相關之PCB、載板的相關產品。
- 2 高階AI伺服器方面，客戶對於高層數HLC+HDI設計需求增多，此為臻鼎之強項，擁有領先的技術布局。
- 3 積極參與客戶前端技術開發，並與客戶洽談次世代架構新品。
- 4 待高雄AI園區啟動及泰國新廠明年進入量產後，臻鼎將有充裕產能支應客戶高速成長的需求。

## 全球折疊手機市場規模：臻鼎已配合多家客戶出貨



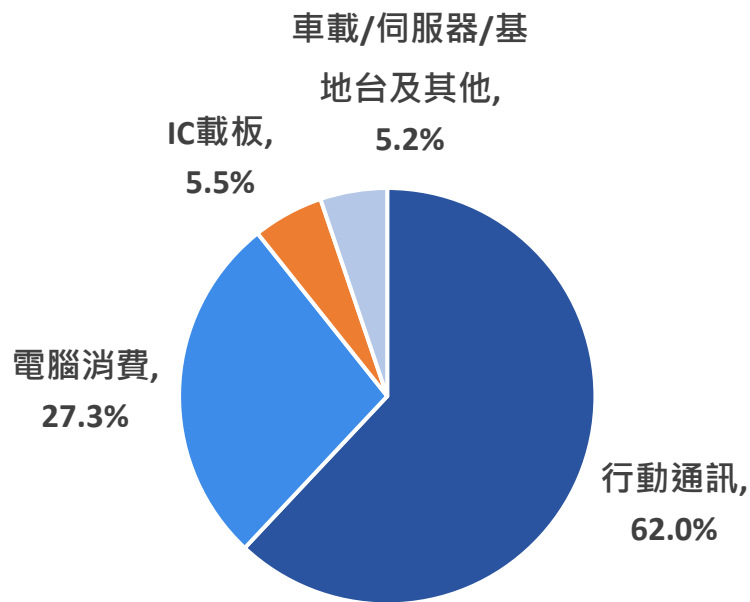
資料來源：IDC(2024/2)

## 全球AI手機市場規模：臻鼎積極與客戶開發新品

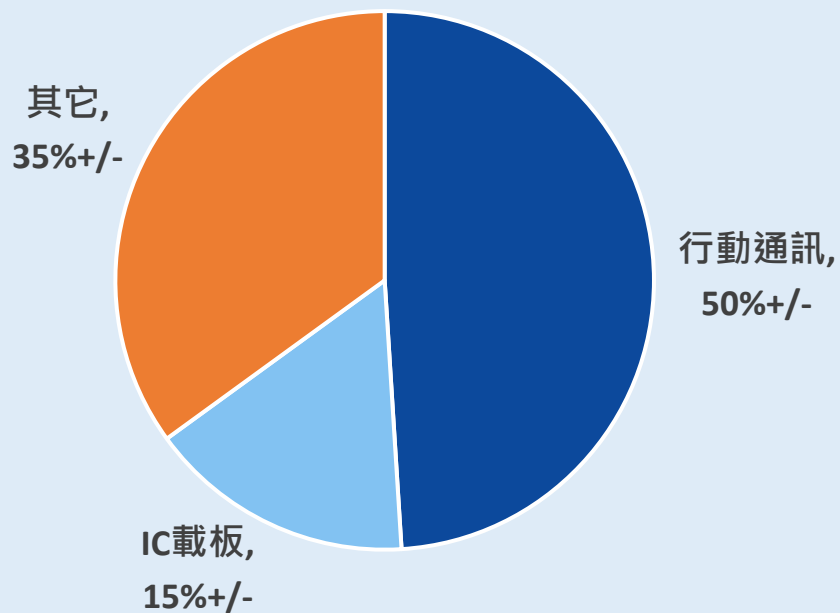


資料來源：IDC(2024/2)

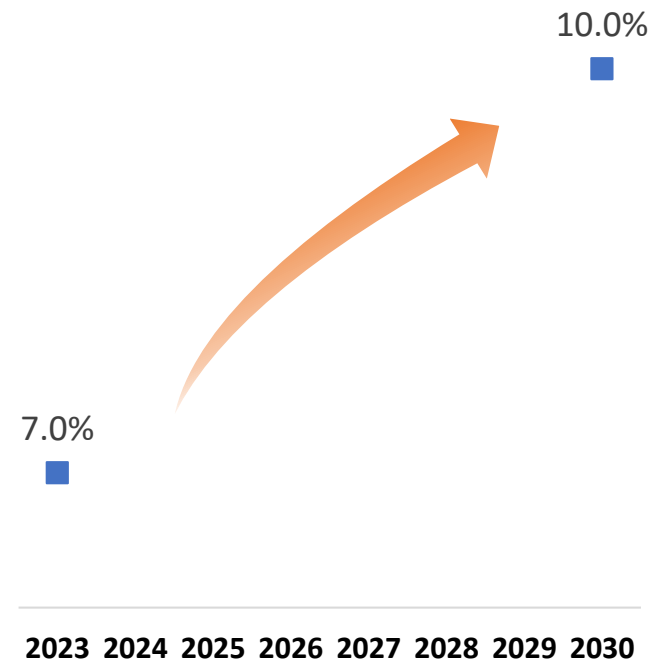
## 1-3Q24營收新台幣1,155億



## 2027年目標營收產品應用比重



## 2030年目標全球市佔率達10%



# 積極拓展IC載板業務

目標2030年成為全球前五大

1

**IC載板營收連續四個季度創下單季新高，前三季營收年增88%，符合公司先前預期：**

- 前三季IC載板營收年增88%，今年全年將維持營收高速成長的預期。中期而言，臻鼎仍目標2023-2027營收複合成長率>50%。

2

**ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝載板的旺盛需求，明年將配合客戶量產下一代產品：**

- 臻鼎ABF載板產能利用率持續提升，主要受惠於Chiplet以及2.5D先進封裝產品的需求。公司預期將於高階車載ADAS晶片產品有所斬獲，並持續配合HPC和AI客戶量產下一代產品。
- ABF載板的高階產品以AI晶片、networking晶片為主，市場需求已見回升，未來隨著產品升級換代，大尺寸(70mm\*70mm以上)及高層數(16層以上)產品占比將逐步增加。

3

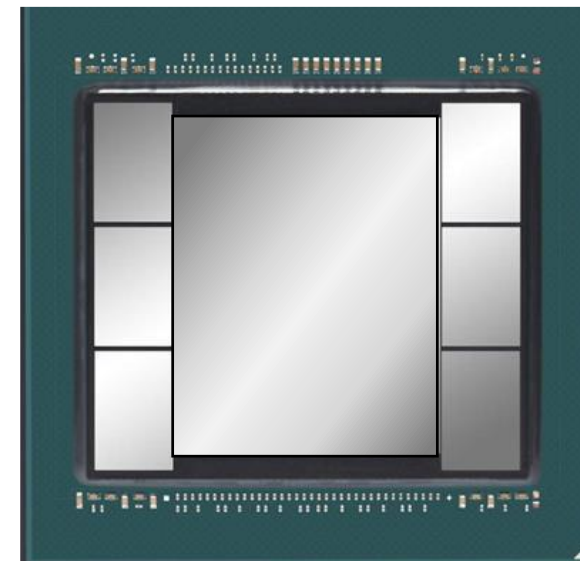
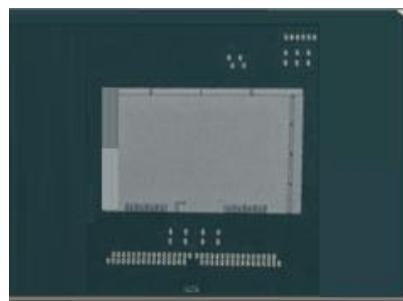
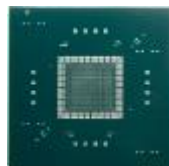
**BT載板營收穩步提升，新客戶與新產品將帶動明年成長：**

- 臻鼎BT載板主要應用為手機處理器、記憶體、及射頻類，明年在新客戶、新產品訂單放量之下，可望持續成長。
- ETS細線路6/8um預計將於年底邁入量產，2024年新開發之DDR-5與NAND載板也會逐季進入量產，公司產品皆達業界tier 1領先水準。



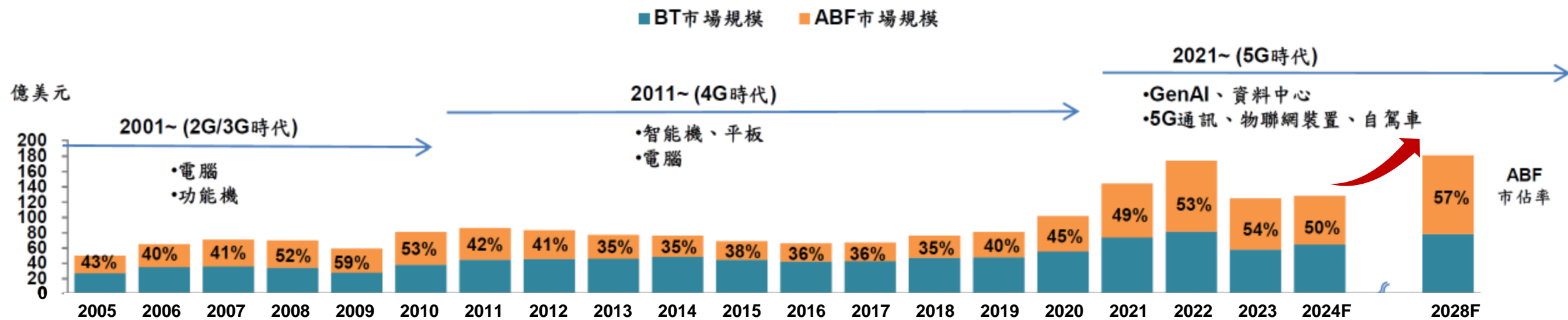
IC載板的複雜程度提升：

層數**高**、  
尺寸**大**、  
表面**平**、  
產品精度**準**



	2005	2020	2026	
Body Size (mm)	31 x 31	75 x 60	120 x 140+	<b>x20+</b>
Layer count (L)	6	20	28+	<b>x4+</b>
Bump Count	1K	100K	300k+ ~ 500k+	<b>x300+</b>

# AI新應用驅動高階載板需求動能



Source: Prismark (2024/9)



## 先進封裝趨勢

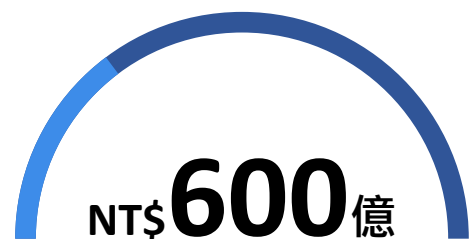
- Chiplet及HBM增加，Bump Area設計會更不規則，對封裝良率要求更嚴格
- 尺寸變大、高層板複雜線路會需求增加
- 封裝良率更複雜，載板作為最重要的元器件，品質要求至關重要
- 車載產品將大量應用先進封裝技術，對載板和關鍵材料有新需求

## 先進Chiplet趨勢

- Interposer變大，Bump Counts增加，大尺寸高層板高階化
- 光電器件是未來必要的趨勢，載板邊緣也會有大量的Bump和佈線、疊孔
- Wafer背部供電，將改變Substrate和封裝結構

## Co-Packaged Optics (CPO)

- CPO是大勢所趨，目前共識最好的載體還是Substrate
- 光電共封CPO能夠提升傳輸效率，並且能夠降低能耗和信號損失
- 關注CPO+CoWoS共封技術



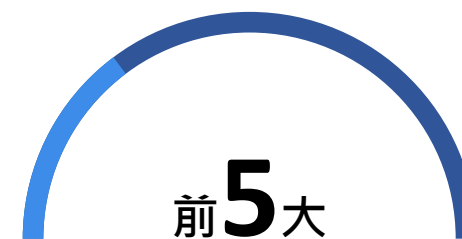
IC載板資本支出：  
2022-2027規劃投資  
600億



IC載板營收：  
2023-2027複合  
成長率 >50%



IC載板營收：  
至2027年，IC載板占  
臻鼎合併營收15%+/-

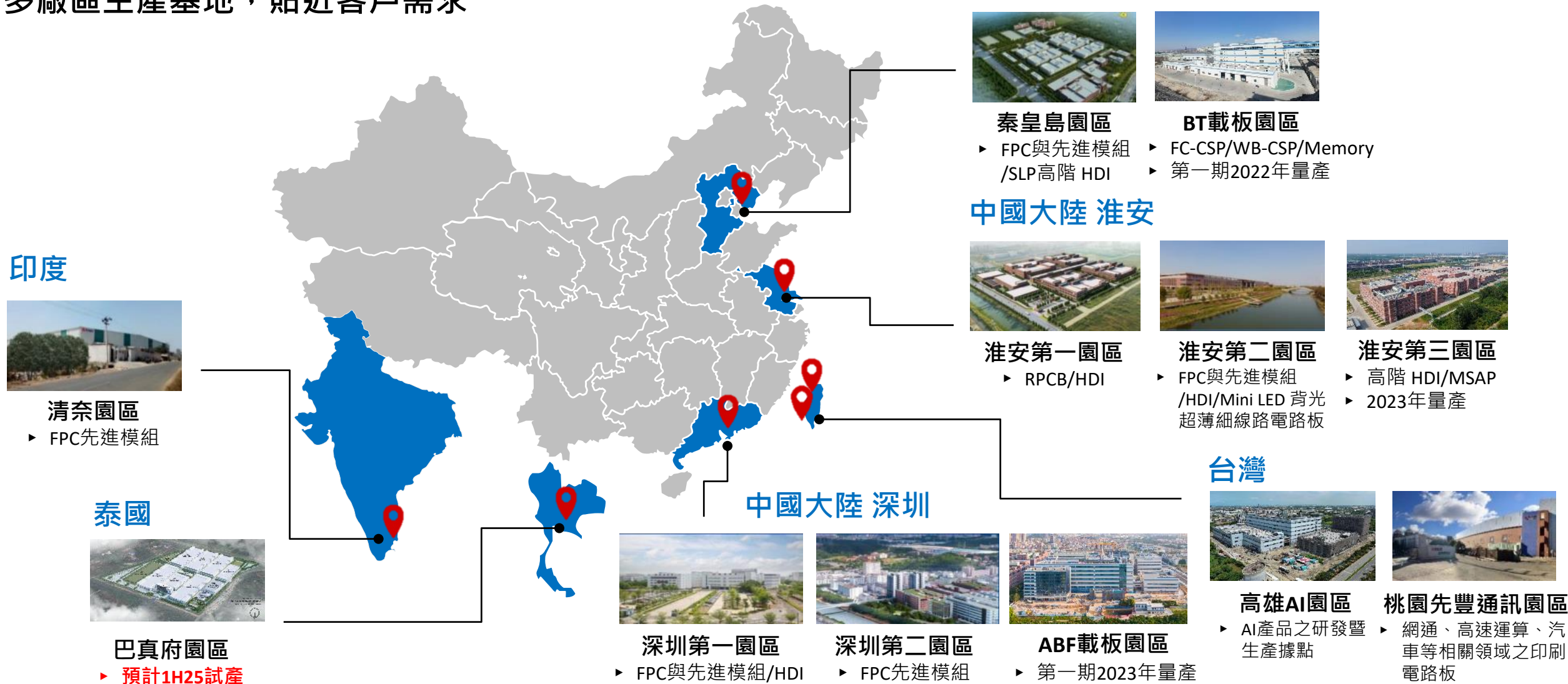


IC載板市占率：  
目標2030年成為IC  
載板全球前五大

# 全球化生產基地

---

## 多廠區生產基地，貼近客戶需求



(去年12月)泰國巴真府園區第一期



(2024/8/26)泰國巴真府園區第一期：上樑典禮

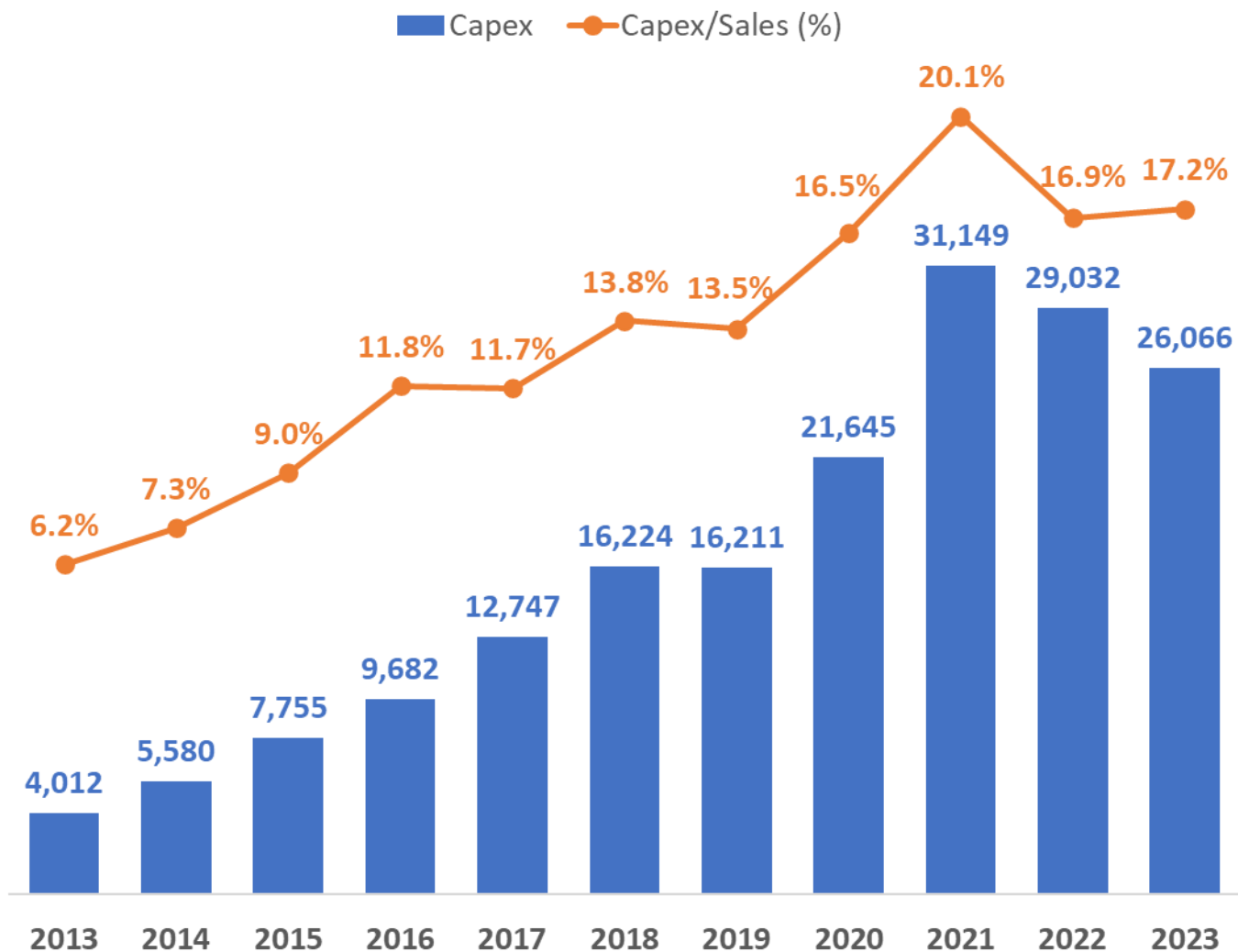


- 泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，廠房已於8/26封頂，年底裝機，1H25試產、2H25小量產
- 第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品
- 為臻鼎東南亞製造重要據點



- 高雄AI園區是臻鼎對應AI市場需求重要的研發暨生產據點





- 身為全球第一大PCB製造商，臻鼎仍定位自身為成長型企業，持續以「糧草先行」策略，及早布局客戶所需產能。
- 今年將持續投入高雄廠與泰國廠的建置，為長期成長奠定基礎。



在One ZDT 策略下，各廠區分階段導入智能管理，目前淮安第三園區新廠已是導入智能管理的第九座工廠，在良率及效率上都有顯著的效益。

## ▶ 臺灣公司治理評鑑

2024年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

## ▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2024年S&P Global ESG 評級進步至76分；連續2年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)，為唯一入選的PCB企業。

## ▶ Sustainalytics ESG 風險評級

2023年Sustainalytics ESG風險評級由17.8進步至15.6，為低等風險等級。

## ▶ ISS ESG 評級

最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「優秀(Prime)」等級。

## ▶ CDP 碳揭露專案

2023年在氣候變遷獲得「B」等級，較去年進步一個等級。在水安全管理獲得「A-」領導等級殊榮，亦較去年進步一等級。

## ▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.4分（滿分為5分），成為台灣上市櫃公司第五名。

# 營運成果摘要

---

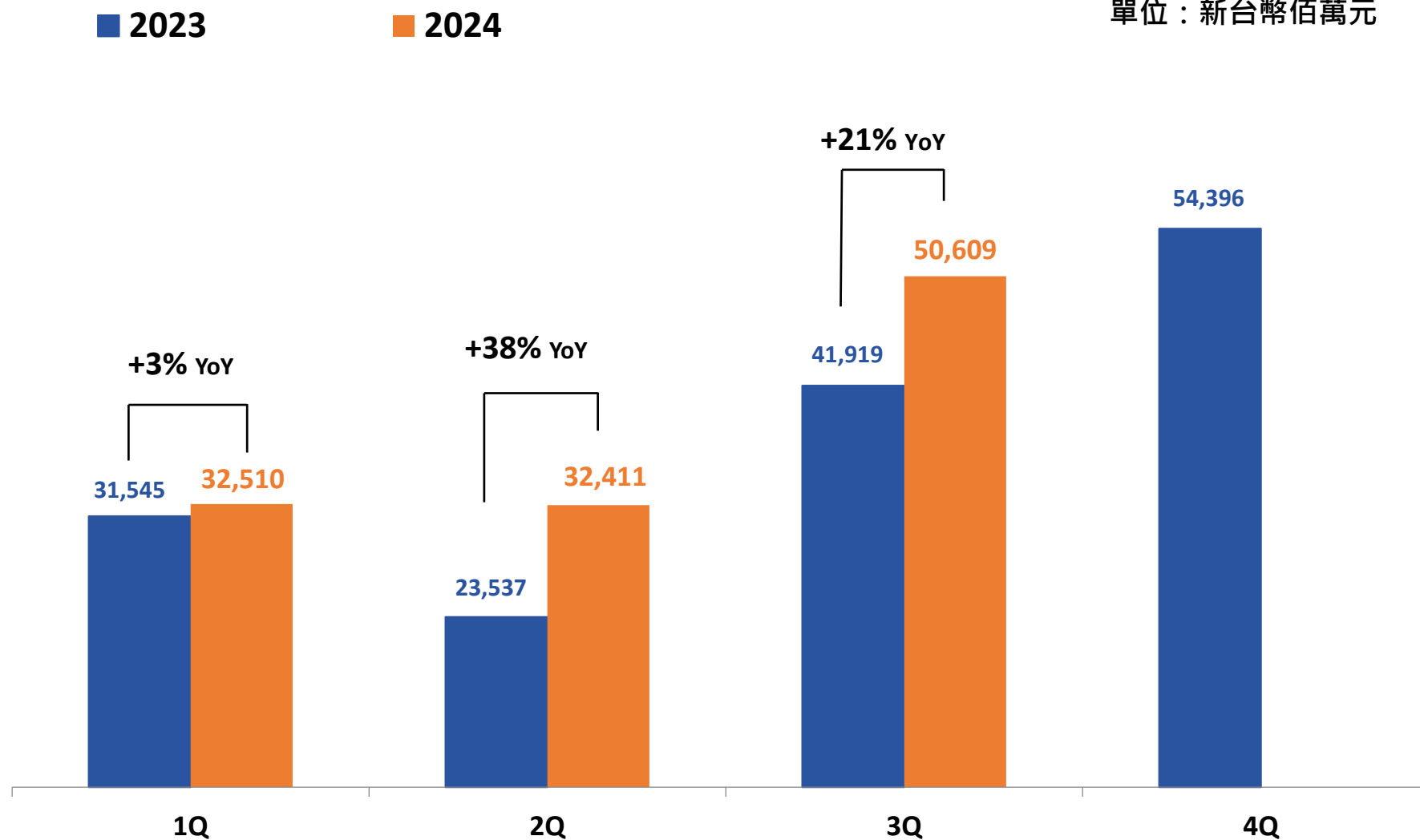
單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1-3Q24	1-3Q23	年變化 (%)
營業收入	115,531	97,002	+19.1%
營業毛利	20,990	15,781	+33.0%
<b>營業毛利率</b>	<b>18.2%</b>	<b>16.3%</b>	<b>+1.9ppts</b>
營業費用	14,958	12,875	+16.2%
營業利益	6,032	2,905	+107.6%
<b>營業利益率</b>	<b>5.2%</b>	<b>3.0%</b>	<b>+2.2ppts</b>
營業外收入及支出	1,253	1,298	-3.4%
本期淨利	6,855	4,362	+57.1%
<b>淨利率</b>	<b>5.9%</b>	<b>4.5%</b>	<b>+1.4ppts</b>
歸屬於母公司之淨利	4,816	2,685	+79.4%
每股盈餘 (新台幣元) <sup>(1)</sup>	<b>5.08</b>	<b>2.84</b>	
研發費用	8,668	6,799	+27.5%
折舊及攤銷	13,094	12,124	+8.0%
營運活動之現金流入	9,542	20,360	-53.6%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	64,714	59,979	+7.9%
股東權益報酬率 (%) <sup>(3)</sup>	<b>6.6%</b>	<b>4.4%</b>	<b>+2.2ppts</b>

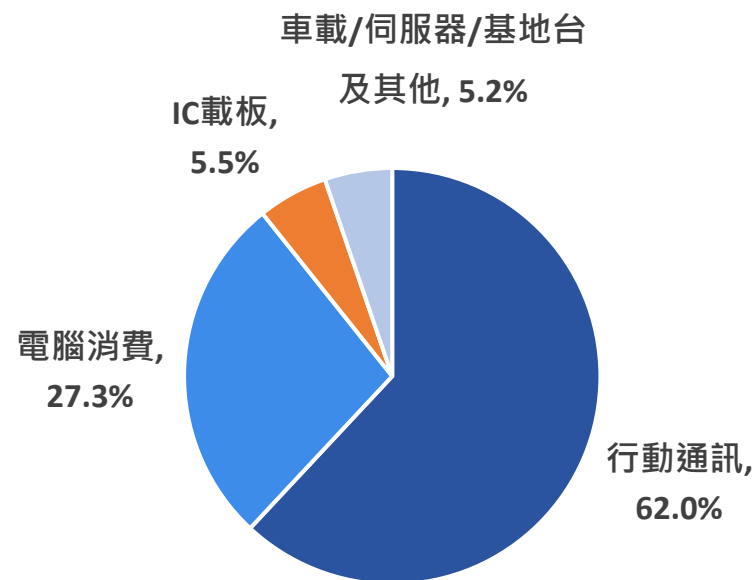
附註：(1) 2024年前三季加權平均流通在外股數為947,678仟股 (實際發行股本956,653仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

## 營業收入

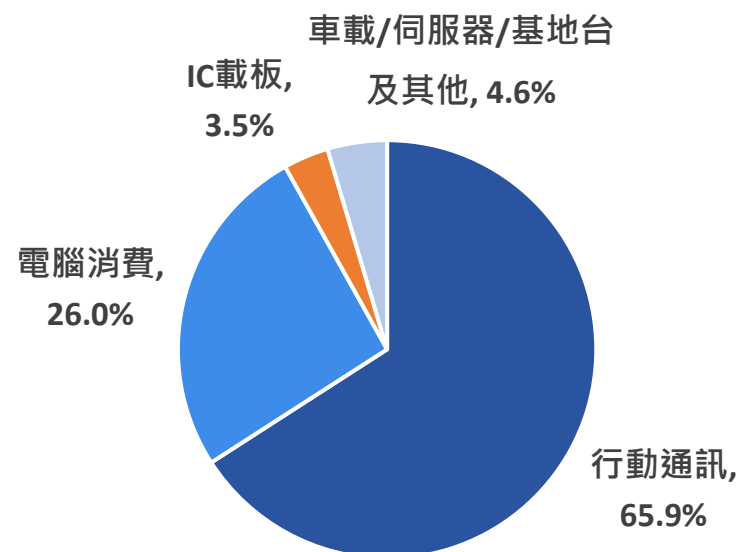
單位：新台幣佰萬元



## 1-3Q24 營收新台幣1,155億



## 1-3Q23 營收新台幣970億



產品別	1-3Q24 營收YoY%
行動通訊	11.9%
電腦消費	25.0%
IC載板	87.9%
車載/伺服器/基地台及其他	36.7%

	2024-9-30		2023-9-30		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	64,714	24.9%	59,979	24.2%	4,736	+0.7ppts
應收款項	35,675	13.7%	32,141	13.0%	3,534	+0.8ppts
存貨	24,799	9.5%	22,311	9.0%	2,487	+0.5ppts
不動產、廠房及設備 <sup>(3)</sup>	111,026	42.8%	112,780	45.5%	-1,754	-2.8ppts
<b>資產總額</b>	<b>259,685</b>	<b>100.0%</b>	<b>247,800</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,886</b>	
借款	56,260	21.7%	51,640	20.8%	4,620	+0.8ppts
應付款項	43,776	16.9%	44,196	17.8%	-420	-1.0ppts
<b>負債總額</b>	<b>115,599</b>	<b>44.5%</b>	<b>113,329</b>	<b>45.7%</b>	<b>2,270</b>	<b>-1.2ppts</b>
<b>股東權益總額</b>	<b>144,087</b>	<b>55.5%</b>	<b>134,471</b>	<b>54.3%</b>	<b>9,616</b>	<b>+1.2ppts</b>
<b>重要財務比率</b>						
平均收現日數(天)	77		87		(10)	
平均銷貨日數(天)	62		72		(10)	
流動比率(倍)	1.78		1.41		0.37	
資產生產力(倍) <sup>(4)</sup>	1.39		1.21		0.18	

附註：(1) 2024年前三季加權平均流通在外股數為947,678仟股 (實際發行股本956,653仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 不動產、廠房及設備 包含 投資性不動產。 (4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。



單位：新台幣佰萬元

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
營業收入	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398
營業毛利	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459
本期淨利	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432
母公司淨利	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189
折舊及攤銷	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323
每股盈餘 (元)	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.550
每股股利 (元)	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275
分派比率 (%)	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%	50.0%
現金及約當現金 *	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970
不動產、廠房及設備	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965
資本額	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%
負債比率 (%)	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%

\* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

# Q&A

---



THANK YOU